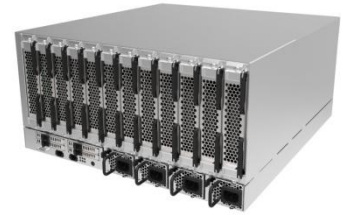


## Artesyn의 MaxCore HA 플랫폼, NFV C-RAN/vRAN 설치비용 75%까지 절감

한국, 서울 [2016년 5월 12일] - [Artesyn Embedded Technologies](#)가 NFV/SDN과 Carrier급 클라우드 네트워크에 쓰이는 마이크로서버 플랫폼의 고가용성 버전인 [MaxCore™ HA](#) 플랫폼을 출시했다. 해당 네트워크는 C-RAN (클라우드형 기지국: Centralized Radio Access Network)이나 vRAN(가상형 기지국: virtualized radio access network)과 같은 신형 네트워크 설비를 포함한다. 이 플랫폼은 중국 내 LTE 배치 등 제한적 공간에 설치하는 차세대형 설치를 위해 설계되었으며 기존 LTE 망에 설치되며 통신용 고가용성 요구조건을 충족시키게 된다.



통신사업자들은 이 같은 다목적의 MaxCore 아키텍처를 활용해 매우 밀집된 단일 기능형 어플라이언스를 만들거나 단일 플랫폼에 음성 또는 영상 트랜스코딩을 하는 단일 VNF(Virtual Network Functions)를 여러 개 구축할 수 있다. 통신사들은 또한 클라우드 인프라 구축의 운영비용과 자본 절감 효과를 얻을 수 있으며 필요에 따라 규모를 조정할 수 있다. 가령, 단일 MaxCore HA 시스템을 활용할 경우 압축된 풋프린트에서 RAN 당 상당히 많은 수의 셀 지원이 가능한데 L1 기술을 이용한 전통적인 랙마운트서버(RMS) 접근 방식과 비교해 냉각비용이나 전력소비 측면에서 상당한 절약이 가능해진다.

Artesyn Embedded Technologies의 커뮤니케이션 플랫폼 마케팅 사업부 부사장인 토드 위니아(Todd Wynia)는 "통신사업자들이 C-RAN이나 vRAN 인프라 구축 시 MaxCore HA 플랫폼을 활용할 경우, RMS 기반 솔루션과 비교해 셀 당 비용을 25% 아낄 수 있다는 추정이 나왔다. 반면 전력소비는 줄이고 밀도는 더 높일 수 있다. 이 신규 플랫폼에 장착된 핫스왑이나 클라킹과 같은 고가용성 기능을 통해 통신사들은 네트워크 엣지로 가는 가상화를 구현하거나 5G로 이행하는 과정에서 모바일 엣지 컴퓨팅 기술(MEC, Mobile Edge Computing) 지원이 가능해진다. 게다가 아티슨의 엑셀러레이터 제품은 기존 서버 인프라나 커스텀 설계형 또는 3자 방식의 PCI Express 카드에서도 작동이 가능하다. 때문에 통신사들은 제약을 받지 않고 구축 과정에서 최대한의 유연성을 발휘할 수 있다"고 밝혔다.

MaxCore HA 플랫폼은 최대 384 Intel® Xeon® D 프로세서 코어를 수용할 수 있어 최고의 밀도를 자랑하는 고가용성 플랫폼 중 하나로 평가 받는다.

인텔의 커뮤니케이션 인프라스트럭처 사업부를 총괄하는 댄 로드리게스(Dan Rodriguez)는 "5세대(5G) 통신을 구현하기 위해선 로컬캐싱(local caching) 기능을 지닌 강력한 네트워크 에지 디바이스가 필요하다"며 "아티슨의 MaxCore 플랫폼을 활용할 경우, NFV나 SDN 기술을 이용해 그 같은 환경을 실현하는 데 도움

을 받을 수 있다. 이는 인텔의 아키텍처 상에서도 매우 탄력적이고 변환이 가능하며 운영비용도 낮출 수 있다"고 언급했다.

아티슨의 MaxCore HA 플랫폼은 5U 높이의 19인치 표준형 랙(rack) 상자에 담겨 있으며 선택가능한 100G 이더넷 인터페이스와 12개의 핫스왑(hot swap) PCI Express 패브릭 슬롯이 특징인 중복스위치 카드를 갖추고 있다. 고객사들은 아티슨 마이크로서버(Artesyntmicroserver)나 샤프스트리머 (SharpStreamer™) 엑셀러레이션 카드, 또는 3자방식의 규격품으로 바로 구매가 가능한 PCI Express 카드를 통해 탄력적으로 변환할 수 있다. 이는 케이블 없이도 고성능의 단일 변환이 가능한 초고속 백플레인을 통해 연결이 된다.

다수의 통신집중형 사무환경에서는 프론트 액세스 방식의 규격 입출력(input/output, I/O)과 프론트투리어(front-to-rear) 냉각방식이 선호된다. 이 플랫폼은 시스템 관리소프트웨어 특징을 가지며 소프트웨어 기능을 구현하는 아티슨의 Silver Lining™ NFV 기능이 있다. 이 소프트웨어는 OpenFlow나 OpenStack, Linux, OVS, DPDK와 같은 오픈소스형 프로젝트를 활용하고 있다.

한편 아티슨은 [C-RAN](#)과 [vRAN](#) 인프라 구축과 관련해 설비투자비용(CapEx) 및 운영비용(OpEx)을 낮추기 위한 두 가지 솔루션 브리프를 최근 공개했다.

### Artesyn Embedded Technologies 소개

Artesyn Embedded Technologies 는 통신, 컴퓨팅, 의료, 군사, 우주항공을 비롯하여 광범위한 산업에서 요구하는 신뢰성 높은 전력 변환 및 임베디드 컴퓨팅 솔루션의 설계 및 제조 분야를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. 시장 출시 시간을 단축하고 비용 효율적인 첨단 네트워크 컴퓨팅 및 파워 컨버전 솔루션을 통해 위험을 경감할 수 있도록 지원하는 Artesyn 의 기술력은 40 년 이상 고객들의 높은 신뢰를 받고 있습니다. Artesyn 의 2 만여 직원들이 전세계에 분포된 우수한 공학센터 10 개소, 세계적 수준의 생산 설비 4 개소, 글로벌 판매 및 지원 사무소에서 근무하고 있습니다.

Artesyn Embedded Technologies, Artesyn 및 Artesyn Embedded Technologies 로고는 Artesyn Embedded Technologies, Inc 의 상표와 서비스 마크입니다. 그 외 언급된 나머지 모든 이름과 로고는 해당 소유주의 상표명, 상표 또는 등록상표입니다. © 2016 Artesyn Embedded Technologies, Inc. All rights reserved. 전체 법률 약관은 [www.artesyn.com/legal](http://www.artesyn.com/legal) 에서 확인할 수 있습니다

### 언론 담당 연락처:

Alice Hui

+852 2176 3548

[Alice.Hui@Artesyn.com](mailto:Alice.Hui@Artesyn.com)